

## USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Data OMNIMATE – konektor USB, USB konektory, 480 Mbps, Pájené připojení SMD, 180°, ≥ 10000, Rozteč v mm (P): 0.65 mm, Počet pólů: 5, LCP, černá, Tape
Objednací číslo	<a href="#">2762070000</a>
Typ	USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK
GTIN (EAN)	4064675035299
Množství	2 000 ks
Balení	Tape

Datum vytvoření 30. května 2024 1:18:33 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2,9 mm	Hloubka (v palcích)	0,114 inch
Výška	10,51 mm	Výška (v palcích)	0,414 inch
Šířka	7,99 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Čistá hmotnost	0,299 g		

## Balení

Balení	Tape	Délka VPE	462 mm
Šířka VPE	450 mm	Výška VPE	166 mm

## Specifikace systému

Cykly zapojování	≥ 10000	Kategorie výkonu	480 Mbps
LED	Ne	Materiál stínění	Nerezová ocel
Montáž na PCB desku	Pájené připojení SMD	Plocha stínění	poniklované
Počet pólů	5	Proces pájení	Pájení přetavením, Manuální pájení
Pájecí kolík, délka (l)	0 mm	Přenosová rychlost	480 Mbps
Rozměry pájecích pinů	Osmiúhlý	Rozteč v mm (P)	0,65 mm
Rozteč v palcích (P)	0,026 "	Skupina produktů	Data OMNIMATE – konektor USB
Stupeň krytí	IP20	Stínění	ano
Tažná síla / pól, min.	10 N	Tolerance rozmístění pájecích pinů	± 0,1 mm
Typ připojení	Patice	Výstupní tvarovka	180°
Zásuvná síla / pól, max.	35 N		

## Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	100 V AC	Izolační síla	≥ 100 MΩ
Jmenovité napětí	48 V	Jmenovitý proud	1 A
Objemový odpor	<25 mΩ		

## Údaje o materiálu

Izolační materiál	LCP	Barevný	černá
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Izolační síla	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Contact base material	Slitina mědi	Materiál kontaktu	Slitina
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Struktura vrstev kontaktu konektoru	≤ 1 μ" Au
Skladovací teplota, min.	-40 °C	Skladovací teplota, max.	70 °C
Provozní teplota, min.	-30 °C	Provozní teplota, max.	80 °C

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

**USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Oznámení o změně produktu

[Änderung der Verpackung – 2762070000 USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK](#)[Change of packaging – 2762070000 USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

### USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

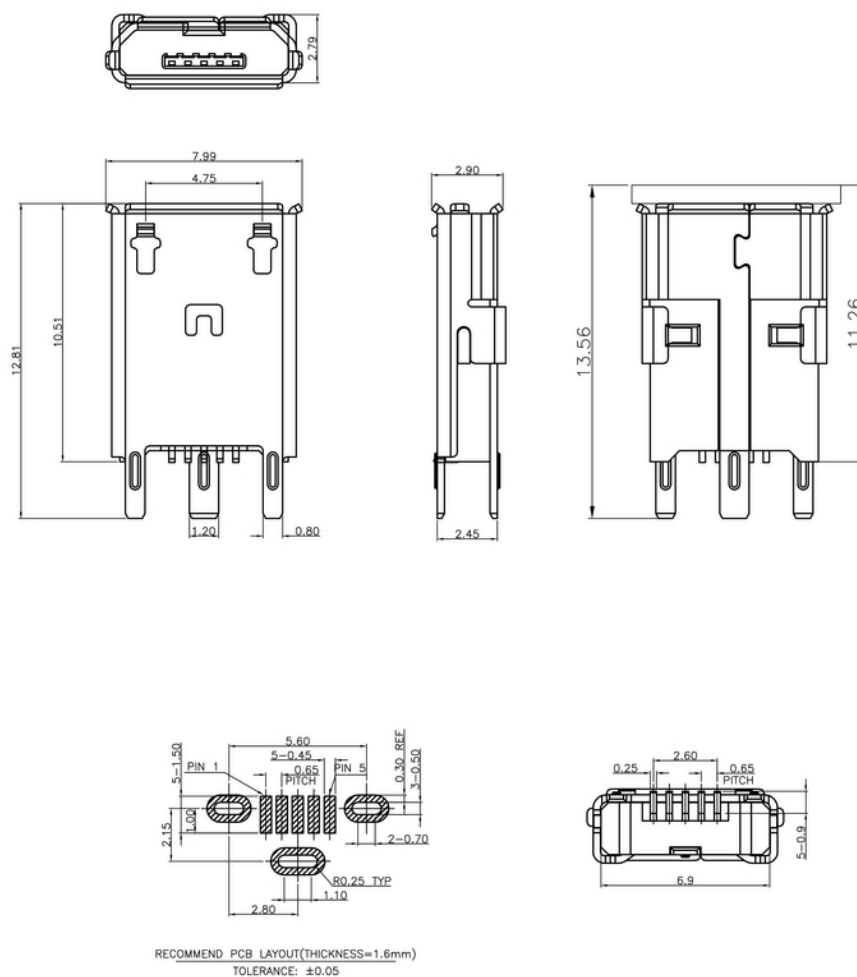
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



Datum vytvoření 30. května 2024 1:18:33 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhradzujeme si právo na technické zmeny.

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.